

■ 量産中

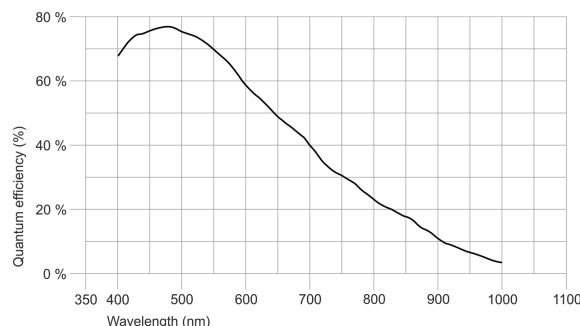
このカメラモデルは量産中で長期にわたりご使用いただけます。



仕様

センサー

センサーのタイプ	CMOS モノクロ
シャッター	ローリングシャッター / グローバル開始シャッター
特性	リニア
読み出しモード	プログレッシブスキャン
解像度/ピクセル	6 MP
有効画素数	6.41 メガピクセル
有効画素数 (h x v)	3088 x 2076 ピクセル
アスペクト比	3:2
ADC	12 bit
色深度 (カメラ)	12 bit
光学センサークラス	1/1.8"
撮像面積	7.411 mm x 4.982 mm
光学センサーの対角	8.93 mm (1/1.79")
画素サイズ	2.4 µm
マイクロレンズシフト	0.00
メーカー	Sony
センサーモデル	IMX178LLJ-C
ゲイン (マスター/RGB)	14.5x/5x
AOI 水平	同じフレームレート
AOI 垂直	増加したフレームレート
AOI 画像の幅、ステップ幅	88 / 8
AOI 画像の高さ、ステップ幅	1 / 1
AOI 位置グリッド (水平/垂直)	8 / 1
ビニング水平	増加したフレームレート
ビニング垂直	増加したフレームレート
ビニング手法	M/C 自動
ビニング係数	2 / 4 / 8
サブサンプリング水平	同じフレームレート
サブサンプリング垂直	同じフレームレート
サブサンプリング手法	M/C 自動
サブサンプリング係数	2, 4, 8



モデル

フレームレートフリーランモード (8ビットモード)	18 fps
フレームレートトリガー (連続)	18 fps
フレームレートトリガー (最大)	18 fps
露出時間 (最小 ~ 最大)	0.031 ms - 2000 ms
長時間露出 (最大)	60000 ms
消費電力	1.8 W - 2.7 W
画像メモリ	128 MB

環境条件

下記の温度は、デバイス外部の温度を基準としています。

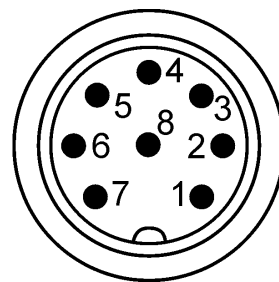
操作中のデバイス温度	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
保管中のデバイス温度	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
湿度 (相対湿度、結露なし)	0 % - 100 %

コネクター

インターフェースコネクター	GigE M12、ねじ止め式
I/O コネクター	Binder 製 8 ピンコネクター (Binder シリーズ 712:09-0427-020-08)
電源	12 V ~ 24 V または PoE

ピン割り当て I/O コネクター

1	オプトカプラありのトリガー入力 (+) - Line 0
2	入力電源 (VCC)、12 ~ 24 V DC
3	汎用入出力 (GPIO) 1 - Line 2
4	接地 (GND)
5	オプトカプラありのフラッシュ出力 (+) - Line 1
6	オプトカプラありのフラッシュ出力 (-) - Line 1
7	オプトカプラありのトリガー入力 (-) - Line 0
8	汎用入出力 (GPIO) 2



設計

レンズマウント	C-マウントレンズ
保護構造	IP65/67
外形寸法	41.0 mm x 53.0 mm x 42.7 mm
重量	173 g

Features

Image Acquisition

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	✓
Long exposure	✓
Line scan	✓
Line scan highspeed	-
Global start	✓

Flashing

Flashing	✓
PWM flashing	✓

技術は変更されることがあります (2024-05-01)

ページ 2 の 3

www.ids-imaging.jp

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · 電話番号 +49 7134 96196-0 · E メール apacsales@ids-imaging.com

Image Adjustments	Auto exposure	✓
	Auto gain	✓
	Auto whitebalance	-
	Color correction	-
	Gamma	✓
	LUT	✓
	Mirror/flip	-
On-board Image Processing	Pixel formats	Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
	Region of interest	✓
	Decimation (FPGA)	✓
	Decimation (Sensor)	-
	Binning (FPGA)	✓
	Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.
Others	IP settings	✓
	Bandwidth management	✓
	Chunks	✓
	Sequencer	-
	PTP	✓
	Firmware update	✓
	1st supported firmware version	2.10